Zum Klienten:
Weitere Informationen zum Klienten und laufend neue Jobchancen erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung und dem Onboarding durch Ihren Fachberater per Mail oder online. Wir freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen!

Arbeitsort:
Zürich (X Kilometer und X Minuten von Ihrer Wohnadresse entfernt)

Jobbeschreibung:
Etch Engineer - Process Owner (w/m/d)

Ihr Aufgabengebiet:
- Entwicklung und Optimierung von FEOL- und BEOL-Plasma-Ätzprozessen für neue Gate-All-Around-Architekturen (u. a. 2-nm-Knoten) sowie etablierte Technologieknoten wie 14nm, 17nm und 28nm FinFET
- Implementierung und Weiterentwicklung von Advanced Process Control (APC), inklusive Feed-Forward-Strategien für Trench-Ätzung und Via-Höhenoptimierung
- Durchführung von SPC/FDC-Monitoring, statistischer Ausbeuteanalyse sowie Ursachenanalysen bei Prozessabweichungen, Interlocks und OCAP-Ereignissen
- Qualifizierung und Integration unterschiedlicher Ätzanlagen-Plattformen (z. B. LAM Research FLEX/KIYO, TEL, Applied Materials, Mattson, PSK, SEMES) für den Produktionseinsatz
- Durchführung von Prozessabgleich und Technologietransfer zwischen globalen Fertigungsstandorten
- Unterstützung des Fabrik-Hochlaufs durch Anlagenqualifizierung, Kapazitätsoptimierung und Durchsatzsteigerung
- Entwicklung von Überwachungsplänen zur Defekterkennung nach präventiver Wartung und zur Qualifizierung von Produktionswafern
- Zusammenarbeit mit Equipment-Engineering-, Prozessintegrations-, Metrologie- und Yield-Teams zur Verbesserung von Prozessstabilität und Fertigungseffizienz
- Einsatz von DOE-Methoden sowie Analysetools wie Spotfire, JMP, Minitab und Python zur Prozessoptimierung und Defektreduktion
- Durchführung von Fehleranalysen und Materialcharakterisierungen mittels SEM, EDX, Spektroskopie und weiteren Verfahren
- Unterstützung der Fertigung für Automobilelektronik, Speicherbausteine, RF-Technologien und fortschrittliche Display-Anwendungen
- Mitwirkung an Kostensenkungs- und Risikobewertungsinitiativen im Bereich Prozess-Hardware-Qualifizierung und Fab-Effizienz

Was Sie ausmacht:
- Bachelorabschluss in Chemieingenieurwesen, Materialwissenschaften, Elektrotechnik, Halbleitertechnik oder einer vergleichbaren technischen Fachrichtung
- Mindestens 24 Monate Erfahrung in der Halbleiter-Plasma-Ätzprozesstechnik in einer fortschrittlichen Fertigungsumgebung
- Erfahrung in der Entwicklung und Betreuung von BEOL- und FEOL-Trocken-Plasma-Ätzprozessen
- Erfahrung mit FinFET- und/oder Gate-All-Around-Technologien, einschliesslich Nanosheet-3D-Transistortechnik und Kupfer-zu-Kupfer-Hybridbonding

- Fundierte Kenntnisse in SPC, FDC, APC und statistischer Ausbeuteanalyse zur Prozessoptimierung
- Erfahrung im Verfassen kritischer Standardarbeitsanweisungen für neue Ätzprozesse
- Erfahrung bei der Einführung neuer Produkte durch Optimierung von Ätzrezepten, Anlagenverteilung und neuartigen APC-Prozessen wie Feed-Forward APC
- Erfahrung in der Anlagenqualifizierung und im Prozessabgleich zur Sicherstellung reproduzierbarer Prozess- und Hardwarebasis
- Erfahrung in der Ursachenanalyse bei Ausbeuteabweichungen und Defektreduktion
- Erfahrung in der Prozessoptimierung mittels Design of Experiments
- Kenntnisse in Halbleitermetrologie und Charakterisierung, inklusive SEM- und EDX-Analyse
- Sicherer Umgang mit statistischen Analysetools wie Spotfire, JMP, Minitab oder Python
- Erfahrung in der Hochvolumenfertigung und Unterstützung des Fabrik-Hochlaufs bei der Überführung von Prototypen in die Serienproduktion

Was diese Stelle ausmacht:

- Umfassendes Versicherungspaket (Kranken-, Zahn- und Sehversicherung)
- Lebensversicherung und Vorsorgeleistungen mit sofortiger Vesting-Regelung
- Betriebsrestaurants und Fitnesseinrichtungen vor Ort
- Bezahlter Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub
- Grosszügige bezahlte Freizeitregelung inklusive zusätzlicher persönlicher und gesetzlicher Feiertage
- Wellness-Angebote und weitere Zusatzleistungen
- Leistungsabhängige Bonusprogramme